

HRG200X

High Rigid Grinder

全自動高剛性2軸研削盤

短時間でダメージがない加工を実現

低加工コスト

高精度加工

鏡面加工を実現します



株式会社東京精密



SiC 基板



LT 基板

対象材料

SiC LT LN 等の難削材

対象ワーク

サイズ：φ3～φ8インチ

加工事例

材料	サイズ	取代	加工時間
SiC	6インチ	100μm	2分
LT	4インチ	100μm	1分
LN	4インチ	100μm	1分

仕様



項番	項目	HRG200X
		全自動高剛性2軸研削盤
1	外観	サイズ：1540(W)X2050(D)X2010(H)mm 重さ：4500kg
2	最大加工径 (mm)	200
3	砥石径 (mm)	250
4	砥石軸回転数 (rpm)	3600
5	ワーク軸回転数 (rpm)	800
6	砥石軸モータ (kw)	6.3
7	ウェハ面内厚みばらつき：TTV(μm)	1
8	ウェハ間厚みばらつき：WTW(μm)	± 1

